

## 汪正平教授

BS (Purdue), Ph.D (Pennsylvania State), MNAE, FIEEE  
中文大學工程學院院長

汪正平教授為國際知名電子工程學學者，美國國家工程學院(NAE)及電機及電子工程師學會(IEEE)院士。汪教授在美國普渡大學取得科學學士學位，並在賓夕法尼亞州州立大學取得哲學博士學位。其後，他獲發獎學金，赴史丹福大學跟隨諾貝爾獎得主 Henry Taube 教授作博士後研究。他亦曾於美國貝爾實驗室工作多年，並於 1992 年獲選為該實驗室的院士。在出任中大工程學院院長前，汪教授擔任美國喬治亞理工學院「董事教授」，以及材料科學及工程學系 Charles Smithgall Institute 講座教授。



汪教授的學術成就蜚聲國際，其研究領域包括聚合電子材料、電子、光子及微機電器件封裝及互連材料、界面結合、納米功能材料的合成和特性等。汪教授成功開創嶄新原料，為半導體的封裝技術帶來革命性影響，對業界貢獻至鉅。他積極鼓勵研究，教研卓越，多年來培育無數科學人才，享譽學界。同時，他亦致力服務業界，於 1992 及 1993 年擔任國際電機及電子工程師學會 (IEEE) 電子元件封裝和生產技術學會會長。汪教授曾獲眾多國際獎譽，包括多項由 IEEE 頒授的殊榮，如電子元件封裝和生產技術領域獎及 David Feldman 卓越貢獻獎、Third Millennium Medal，以及 EAB 教育獎。此外，他於 2004 年獲喬治亞理工學院 1934 年度校友傑出教授獎，並剛獲選為賓夕法尼亞州州立大學的傑出校友。

汪教授著作等身，發表專業論文一千餘篇，研究成果豐碩，現持有五十多項美國專利。